

全自动光学 BGA 返修工作站



RD-200

1.概述

RD-200 是一种带光学对位系统拆装一体化，用于拆焊各类封装形式芯片的返修工作站。

2. 产品描述

2. 1 产品特点

- 热风头和贴装头一体化设计，具有自动焊接和自动拆焊功能；
- 上部热风头为新型一体化加热方式，具有红外、热风混合加热特点，升温速率快，可使被拆 BGA 和周边 BGA 产生较大的温差，在拆焊过程中不影响到周边 BGA，此功能最适合芯片与芯片间距离小的电子元件；
- 上下热风,底部红外，三个温区独立加热.加热时间和温度全部在触摸屏上显示；
- 移动式底部预热面积大，PCB 夹具可 X,Y 轴灵活调节，最大夹板尺寸可达 550*500mm；
- 底部强力横流风扇制冷，降温迅速可靠；
- 彩色高清光学视觉系统,具分光双色、放大和微调功能，含色差分辨装置，自动对焦、软件操作功能，22 倍光学变焦，可返修最大 BGA 尺寸 70*70mm，可返修最小 BGA 尺寸 1.5*1.5mm；
- 嵌入式工控电脑，触摸屏人机界面。PLC 控制，实时温度曲线显示，可显示设定曲线和实测曲线，可对测温曲线进行分析；
- 内置真空泵， Φ 角度 60° 旋转，精密微调贴装吸嘴；
- 8 段升(降)温+8 段恒温控制，可海量存储温度曲线，在触摸屏上即可进行曲线分析；
- 吸嘴可自动识别吸料和贴装高度，压力可控制在微小范围内；
- 多种尺寸合金热风喷嘴，易于更换，可 360° 任意角度定位。
- 彩色光学视觉系统由电机自动移动。
- 采用带有定位刻度的治具上完成自动取放芯片。
- 配置测温端口，具有实时温度监测与分析功能。

2.2 备品配件

标配:

- 1) 标准喷嘴 1 个 (根据客户需求订做)
- 2) 下部大、小喷嘴各 1 个
- 3) 内六角扳手 1 套
- 4) 说明书 1 本
- 5) 毛刷 1 支
- 6) 吸嘴 1 个
- 7) 测温线 1 条
- 8) 鼠标 1 个
- 9) 铝片一块

3.装置规格

- 1、设备型号 RD-200
- 2、最大 PCB 尺寸: W550*D500mm
- 3、PCB 厚度: 0.5~2.5mm
- 4、适用芯片: 1*1~70*70mm
- 5、适用芯片最小间距: 0.15mm
- 6、贴装最大荷重: 150g
- 7、贴装精度: $\pm 0.01\text{mm}$
- 8、PCB 定位方式: 外形
- 9、工作台微调: 前后 $\pm 10\text{mm}$,左右 $\pm 10\text{mm}$
- 10、温度控制方式: K 型热电偶、闭环控制
- 11、下部热风加热: 热风 800W
- 12、上部热风加热: 热风 1200W
- 13、底部预热: 红外 3600W
- 14、使用电源: 单相 220V、50/60Hz
- 15、机器尺寸: L850*W750*H630mm
- 16、机器重量: 约 80KG

酷特機器株式会社

COOKTECH INSTRUMENTS CO., LTD.